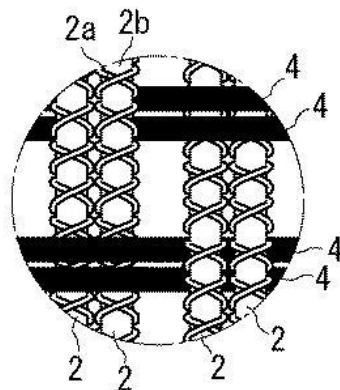


|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 公開番号／特許登録番号 | 特許5914951                  |
| 発明の名称       | 電子部品実装織地、電子部品実装体及びそれを用いた布帛 |
| 出願人または特許権者  | 福井県<br>国立研究開発法人 産業技術総合研究所  |

発明の内容 (概要)

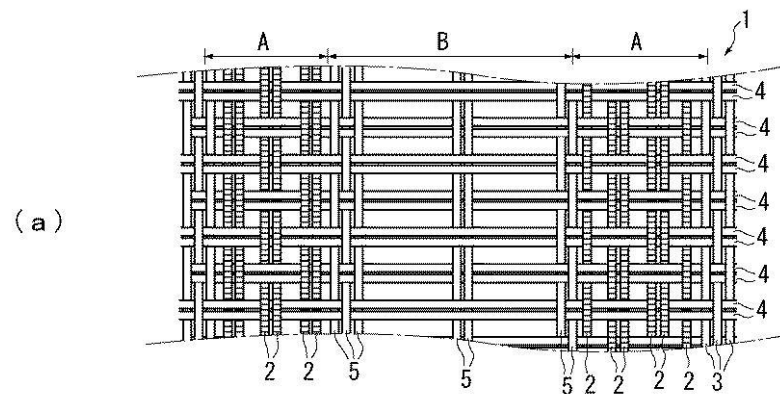
【課題】本発明は、引張りや折り曲げに対して従来の布帛と同様の耐久性を備えている電子部品実装用織地、電子部品実装体及びそれを用いた布帛を提供することを目的とするものである。

【解決手段】電子部品実装用織地は、並列配置された複数の導電糸2及び絶縁糸3が配列された経糸と絶縁糸4が配列された緯糸とを織成して形成された複数の接続領域Aと、接続領域Aの間に絶縁糸5が配列された経糸と絶縁糸4が配列された緯糸とを織成して形成されるとともに電子部品を配置する空隙が形成可能となるように形成された実装領域Bとを備えている。



導電糸に関する一部拡大図

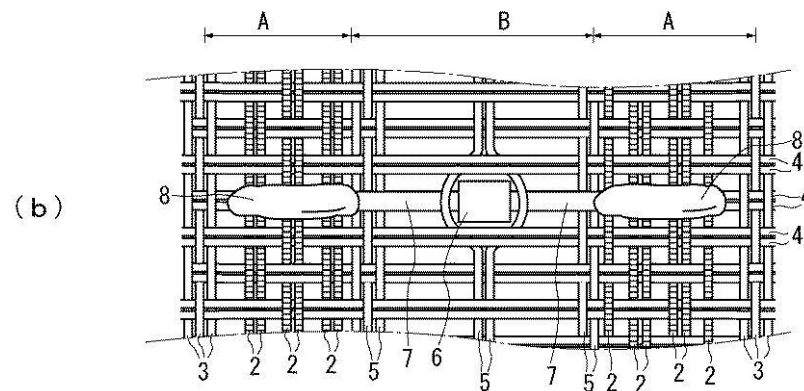
- 1：織地、2：導電糸、3：絶縁糸、4：絶縁糸、5：絶縁糸、
- 6：本体部分、7：接続端子部分、8：接続材、9：補助導電糸、
- 10：電子部品、11：フレキシブル基板、12：LED素子、
- 13：電流調整用抵抗、14：接続パッド、20：実装装置



(a)

(a)織地1は、接続領域A及び実装領域Bを備えており、実装領域Bは、接続領域Aの間に形成されている。

本発明に係る織地及び電子部品実装体に関する一部拡大平面図(a)(b)



(b)

(b)電子部品を織地1に実装する場合